

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

## 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表

编号：2024-0509-013

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：网络会议
参与单位名称	贝莱德 花旗环球金融亚洲有限公司、Sumitomo Mitsui DS AM CO、BlackRock Inv Mgmt LLC (NJ)、Yiheng Capital LLC、Mirae Asset Management、Cathay Securities Investment Trust、Neuberger & Berman、Rays Capital Partners Limited、Eurizon Capital SGR SPA、Fubon Securities Investment Trust、Cathay Securities Investment Trust、Citigroup Internal、Goldman Sachs Asset Management、Dymon Asia Capital (Singapore)、Sumitomo Mitsui Trust Bank、Invesco Asia、Orchid China Management Limited、Barings LLC、Pleiad Investment Advisors Ltd、Allianz Asia、KEYSTONE INVESTORS PTE LTD、BOCI Prudential Asset Management、POLYMER CAPITAL MAN (HK)、Fullerton Fund Management Company Ltd、Value Partners  (因采取电话会议、网络会议形式，参会者未签署书面调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。)
时间	2024年5月9日 13:50-14:50 电话会议 贝莱德 2024年5月9日 15:00-16:00 网络会议
地点	电话会议、网络会议
公司接待人员	钱元君
投资者关系活动主要内容介绍	公司声明：受商业政策限制，未经许可公司不便讨论具体的厂商。PCB属于被动元器件，具体经营情况受多种因素影响，在目前的时点，对于2024年第二季度的业绩情况也很难给出具体的指引。希望更多的就行业发展变化的趋势以及过程中可能存在的一些不确定性因素和大家做交流，敬请谅解。

## 一、公司 2024 年第一季度经营情况

2024年第一季度，公司实现营业收入约25.84亿元，同比增长38.34%，实现归属于上市公司股东的净利润约5.15亿元，同比增长157.03%；每股收益0.2694元，同比增长约155.11%。

## 二、行业情况

### (1) 企业通讯市场板业务情况

2023年由ChatGPT的显著成功引发新一轮人工智能和算力革命，随着全球通用人工智能技术加速演进，人工智能训练和推理需求持续扩大，对AI服务器和高速网络系统的旺盛需求推动对大尺寸、高速高多层PCB的需求，其高负载工作环境也对PCB的规格、品质提出了更高的要求。技术从出现到稳定，再到商业化普及，原生应用大量出现，都需要时间。现阶段AI应用中“杀手级”场景尚未普遍落地。

从短期看高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高多层印制电路板的结构性需求依然不错，但需求的持续快速落地受芯片等供应、技术发展速度、大厂资本开支节奏、应用场景落地、法律法规、伦理规范和政策监管体系的完善等多方面因素的影响，存在诸多可能的不确定性。

从中长期来看随着AI的应用场景逐渐落地，图像、语音、机器视觉和游戏等领域的数据将呈现爆发式增长，新兴人工智能应用的巨大计算和存储需求或将成为未来五年电子市场中主要的增长动力，并为能够提供高性能PCB解决方案的企业带来可期的市场机遇。

传统数据中心领域，尽管由于部分大型云服务提供商正在进行的库存消化周期，以及他们将投资重点转向人工智能基础设施建设，传统云端服务器市场增长减速，但整个供应链的库存水平也已逐渐下降到较合理水准，全球范围内大型云服务和互联网厂商对基础设施的投资也不会停滞，相关需求有望探底回升。

公司将持续加大在技术和创新方面的投资，通过深度参与客户产品的预研和开发，准确把握未来的产品与技术方向，进行新技术新工艺的研发，储备关键核心技术，以技术、质量和服务为客户提供更高的价值，以确定性应对不确定性。

公司也在整合生产和管理资源，并相应针对性的扩充产能。2024年初公司决议投资约5.1亿元人民币，实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目（下称“技改项目”）。技改项目实施后将提高公司面向算力网络相关产品的HDI阶数、层数，提升相关产品的品质稳定性及可靠性，提升生产线数字化、智

	<p><u>能化水平。</u></p> <p>(2) 汽车板业务情况</p> <p>受新能源和智能化等浪潮冲击，随着新能源车渗透率快速提升，燃油车庞大的传统产能与逐步萎缩的市场矛盾加剧，旧有汽车企业竞争格局开始松动，而新的格局尚未形成，规模决定成本和企业生存状态，多数厂商也将优先保份额，汽车价格战愈演愈烈，降价潮几乎贯穿了整个2023年。在连续多年高基数背景下，新能源汽车增长速度或将下降，但其渗透率仍将不断提升，并面临激烈竞争，直到新的格局形成。2024年伊始，新能源汽车价格战再度打响，传统车企和造车新势力纷纷加入，官宣降价或推出限时优惠。</p> <p>从中长期看，消费者希望降低用车成本的强烈期望助推了全球电动汽车渗透率的上涨；消费者对智能技术的偏好则促使全球汽车行业参与者推出提升出行体验的服务，因此汽车行业电气化、智能化和网联化等多种颠覆性趋势变化的步伐不会停滞，其技术升级迭代和渗透率提升将为多层、高阶HDI、高频高速、耐高压、耐高温、高集成等方向的汽车板细分市场提供强劲的长期增长机会。而<u>汽车用PCB一定程度上呈现新兴高端细分市场供给不足，中低端供给过剩的特征，面对更加多元、复杂且持续变化的汽车行业，中低端汽车用PCB价格竞争预期将更加激烈，对汽车板厂商的硬实力和软实力都提出了更大的考验和挑战。</u></p> <p>三、海外基地进展情况</p> <p>由于海外客户更加关注并加强地缘供应链风险分散战略的实施，多区域分散风险运营能力或将逐步成为行业未来成长的关键，<u>公司泰国子公司预期在2024年第四季度实现量产。</u></p> <p>注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024年5月9日